



Heavy Ribbon Wedge-Wedge Bonder

5350HR

Bond System

Drahttypen	Aluminium Bändchen bis 2000x300µm Kupferdrähte 300-500µm auf 4" Spule
Bondkopf	Wedge-Wedge für Bändchen, Standard Tool 2" Länge (bis 90mm) Motorisierte Drahtabspulung (optional) Programmierbares Voice-Coil Bondkraftsystem Von 0 bis 1.800 cN (verstärkbar bis zu 4.000 cN)
Ultraschall System	F&S Generator 58kHz (optional 40, 90, 120kHz)

Maschinen Basis

Achsen	<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare lineare Z-Achse mit 60mm Hub • Programmierbare lineare Y-Achse mit 20mm Hub • Standard-Arbeitshöhe: 55 mm • Manipulator in X und Y: 18x18 mm • entspricht Untersetzung: 1:7
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • Stepper-Motor getriebene Z-Linearachse, • Singleboard-PC, menügeführtes Teach-In, • interne Festplatte, Bedienung und Menüführung über Shuttlerad mit Quittierungstaster
Software	<ul style="list-style-type: none"> • programmierbare Einzelbonds • Loopformen speicherbar
Steuerung	Manuell, Teil-Automatisch
Abmessung	B x T x H – 63 x 58 x 40 cm, Gewicht ca. 30kg
Anschlüsse	100-230 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
Heizung	Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Die 53xx Serie:

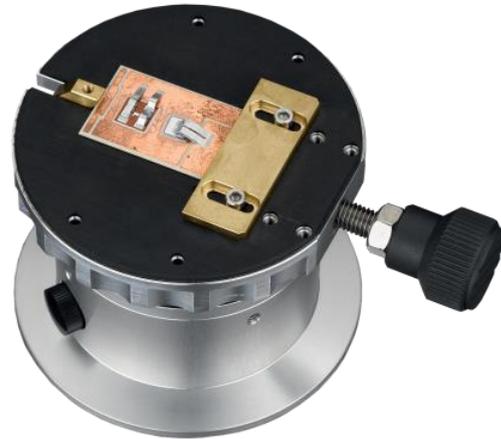
Der Bondkopf 5350HRC für dicke Bändchen und Kupferdrähte ist der neueste Zuwachs in unserer sehr erfolgreichen Handbonder-Familie 53xx. Er ist die perfekte Wahl für F&E, Musterbau, Pilotproduktion und Reparatur, wenn nur ein begrenztes Budget vorhanden ist, aber höchste Bondqualität gefordert wird. Mit dem 5350HR werden die neuesten Bondtechnologien mit dicken Aluminiumbändchen und Kupferdraht für jeden verfügbar.

Diese Materialien sind bedeutend steifer als Standard-Alu-Dickdrahte. Deshalb haben wir eine Drahtführung mit integrierter, programmierbarer Klammer entwickelt, um gleichformige Loopform und reproduzierbare Schnitte auch bei steifen und harten Bondmaterialien sicherzustellen. Die erhöhte maximale Bondkraft von 4000 cN erlaubt das Bonden von dicken Alu-Bändchen bis 2000 x 300 µm.

Wenn auch Sie für komplexe Bondaufgaben optimale Qualität zum günstigen Preis suchen, ist diese Maschine genau richtig für Sie.

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
für Bauteile bis 2x2"
mit mechanischer Klemmung



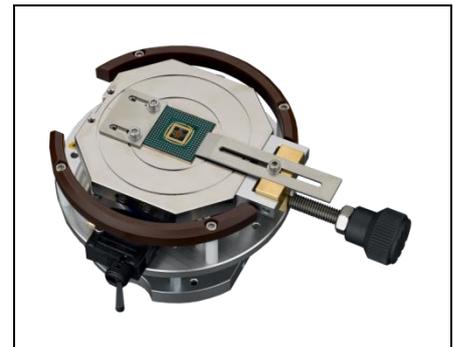
Optional:



Substrataufnahme
für Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mech. Klemmung



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



Ø80mm Substrataufnahme
mit mechanischer Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a
A-5280 Braunau am Inn
Tel.: +43-7722-67052-8270
Fax: +43-7722-67052-8272
Mail: info@fsbondtec.at
Web: www.fsbondtec.at

Hilpert electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:
Hilpert electronics AG
Täferstrasse 29
5405 Baden-Dättwil
Schweiz / Suisse
Tel: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
Mail: office@hilpert.ch
Web: www.hilpert.ch

